



SLE, une Division de Tundra, propose un cœur IP pour le protocole d'interconnexion Interlaken à haut débit
Silicon Logic Engineering développe un coeur IP évolutif pour l'équipement de communication de nouvelle génération

Eau Claire, Wisconsin - 23 janvier 2007 – Silicon Logic Engineering Inc. (SLE), une division de services de conception de semi-conducteurs hautement performants de Tundra Semiconductor Corporation, a annoncé aujourd'hui le développement d'un coeur IP pour protocole Interlaken licencié pour les conceptions ASIC ou FPGA.

Le cœur IP Interlaken de SLE est évolutif, avec des premières versions allant de 10Gbps à 60+Gbps de bande passante à travers l'interface. Les futures versions fourniront une bande passante de plus de 120 Gbps. Cette capacité d'évolution convient particulièrement aux futures générations de commutateurs, routeurs et équipement de stockage basés sur le protocole Interlaken. L'évolutivité est assurée par la combinaison de la vitesse SERDES (3.125Gbps à 6.375Gbps) et d'un nombre variable de canaux SERDES (1 à 24).

Conçu et testé pour être facilement synthétisable dans toute une gamme de technologies ASIC et FPGA, le cœur IP Interlaken a également été créé pour être compatible avec les circuits prêts à l'emploi SERDES des principaux fournisseurs de technologie. Les clients de SLE peuvent désormais intégrer rapidement le cœur IP Interlaken dans la technologie de leur choix, en utilisant les circuits fiables SERDES.

Le protocole ouvert Interlaken a été développé conjointement par Cortina Systems et Cisco Systems pour apporter un protocole d'interface de puce à puce bien plus évolutif que les précédents. Interlaken préserve les avantages réputés des interfaces SPI4.2 et XAUI en intégrant les caractéristiques de découpage en canaux et de contrôle des flux par canal de l'interface SPI4.2, tout en réduisant le nombre de broches E/S grâce à l'utilisation de la technologie grande vitesse SERDES, tout comme dans l'interface XAUI.

Le Vice-président des Services de Conception de Tundra, Jeff West, a précisé aujourd'hui "Tundra a encore démontré sa position de leader des technologies d'interconnexion en intégrant le protocole Interlaken à son portefeuille d'IP et de services et en collaborant avec ses partenaires pour apporter aux clients des solutions à la pointe de la technologie".

Zino Chair, Vice-président du Marketing de Cortina Systems a affirmé, "En travaillant avec SLE, les clients peuvent bénéficier des avantages d'Interlaken, une interface ouverte très performante pour l'équipement de communication". "Interlaken permet aux fournisseurs de silicium de faire évoluer leurs composants jusqu'à 40Gbps et au-delà, de simplifier la conception et de réduire le coût de développement".

"Les utilisateurs du protocole Interlaken de SLE trouveront qu'il est plus facile à évaluer, à intégrer et à tester que les protocoles existants", a affirmé Matt Weber, Ingénieur hardware et Concepteur senior, SLE. "Le développement SLE est en très bonne voie et nous collaborons actuellement avec nos premiers clients et les principaux fournisseurs ASIC et FPGA pour appliquer Interlaken à de nombreuses technologies, tout comme nous l'avons fait avec notre technologie SPI4.2 IP".

Disponibilité produit

Le protocole Interlaken licencié de SLE est disponible auprès du réseau de revendeurs de SLE. Pour toute information sur la vente, veuillez contacter le service Ventes de SLE par email à sales@siliconlogic.com ou par téléphone au 1-908-580-1870.

À propos de Tundra

Tundra Semiconductor Corporation ([TSX:TUN](http://www.tsx.com/TSX:TUN)) est leader mondial en solutions d'interconnexion de systèmes offrant une assistance technique de niveau international et des solutions semi-conducteurs de tout premier ordre aux principaux fournisseurs de systèmes de communication, de mise en réseaux, de systèmes de stockage et de technologie de l'information. La technologie System Interconnect de Tundra c'est aussi la garantie des performances au niveau du système permettant de réduire le délai de mise en marché, d'assurer un avantage sur le marché des infrastructures sans fil, du stockage en réseau, de l'accès au réseau, de l'automatisation militaire et industrielle et des technologies de l'information. Silicon Logic Engineering, Inc. (SLE), est une filiale à 100 % de Tundra. Elle offre des services de conception de semi-conducteurs, des prestations de conseil en propriété industrielle et en développement produit à la pointe de l'industrie.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site <http://www.tundra.com>.

À propos de Silicon Logic Engineering

Silicon Logic Engineering, Inc. (SLE) est spécialisée dans les services de conception "bons du premier coup" englobant tous les aspects de développement des ASIC, des FPGA et des services de conception de systèmes semi-conducteurs. Le processus de conception fiable et reproductible Think Physical™, la propriété intellectuelle des outils et des semi-conducteurs de SLE réduisent le temps de mise sur le marché et sont proposés par l'une des équipes de conception de VLSI les plus expérimentées de l'industrie. SLE est une division de Tundra Semiconductor Corporation ([TSX:TUN](http://www.tsx.com/TSX:TUN)). Pour plus de renseignements sur SLE, visitez le site <http://www.siliconlogic.com>.

À propos de Cortina Systems

Cortina Systems, Inc. est un des leaders de solutions de communication intelligente à la pointe de l'innovation dans le traitement avancé des ports de connectivité intelligente dans les secteurs des cœurs de processeur, des réseaux métropolitains, des accès et des entreprises. Grâce à la maîtrise de l'intégration numérique et analogique à haut débit, nous offrons une vaste gamme de produits pour répondre aux besoins de nos clients en termes de performance, de densité et de flexibilité en réduisant le temps de mise sur le marché, en augmentant la durée de commercialisation et la rentabilité. En établissant une étroite collaboration avec nos clients afin de mieux comprendre les exigences de leur système et d'anticiper leurs besoins, nous créons les fondements de nouvelles générations de services. Pour plus de renseignements sur Cortina Systems, veuillez visiter le site <http://www.cortina-systems.com>

SLE, les logos SLE et Think Physical sont des marques commerciales de Silicon Logic Engineering, Inc. TUNDRA et le logo Tundra sont des marques déposées de Tundra Semiconductor Corporation au Canada, dans l'Union Européenne et en République Populaire de Chine (dépôt en cours aux États-Unis). Design.Connect.Go. est une marque commerciale de Tundra Semiconductor Corporation.

(C) Copyright 2007 Silicon Logic Engineering, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent communiqué peuvent être modifiées sans aucun préavis

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Amérique du Nord
Anna Sizer
Sizer Communications LLC
1.715.533.0155
Anna@sizercommunications.com

Europe
Rob Davies
+ 44 (0)1225 470000
rob.davies@publitek.com

Chine
Jo Soo
+ 852.2837.4727
jo.soo@edelman.com

Définitions :

ASIC : Application Specific Integrated Circuit : Circuit intégré d'application spécifique

ASIC grande capacité : Gravure en 90nm ou inférieur, 30 millions de portes logiques ou plus, avec ou sans des contraintes d'économie d'énergie.

FPGA : Field Programmable Gate Array : Réseau de portes programmable in situ

Broches E/S : Broches d'entrée et de sortie

IP : Propriété intellectuelle. Le présent communiqué de presse concerne les blocs ASIC ou FPG de propriété intellectuelle.

Interlaken : Un protocole puce à puce extrêmement évolutif écrit comme une spécification ouverte par Cortina Systems et Cisto Systems, développé en tant que propriété intellectuelle licenciable ASCII et FPGA par SLE.

SERDES : SERDES est un émetteur/récepteur (sérialiseur/désérialiseur) qui convertit les données parallèles en données série et vice-versa, ce qui réduit de nombre de signaux nécessaires dans une interface puce à puce.

SPI4.2 : Le System Packet Interface Level 4 Phase 2 : Interface paquet de système Niveau 4, Phase 2 est une interconnexion grande vitesse pour applications à bande passante agrégative de 10Gbps. Le standard SPI4.2 a été créé par Optical Internetworking Forum <http://www.oiforum.com>. Le SPI4.2 est également connu sous les abréviations SPI-4.2, SPI-4 Phase 2 et SPI Niveau 4 Phase 2.

VLSI : Very Large Scale Integration : Intégration à très grande échelle

XAUI : Interconnexion puce à puce utilisant quatre canaux de 3.125Gbps de données série XAUI est définie par la norme IEEE802.3ae et utilisée dans des systèmes Ethernet de 10 Gigabits (10GbE).